

上海韦尔半导体股份有限公司

投资者交流活动记录表

投资者交流活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	<p>安信基金，百年保险资管，宝盈基金，保德信证券，贝莱德建信理财，彼得明奇私募基金、博时基金，博裕资本、招商银行，财通证券，财信证券，创金合信基金，重阳投资，大成基金，大和日华咨询，大家资管，淡水泉，德邦证券，东方阿尔法基金，东方证券资管，东吴基金，东吴证券，东兴基金，东兴证券，方正证券，财通证券资管，富达国际，富国基金，高毅资管，格林基金，工银瑞信基金，光大保德信基金，光大理财，光大证券资管，广发基金，广发证券，国海富兰克林，国海证券，国金证券，国融证券，国泰基金，国泰君安证券，国泰瑞丰投资，国投瑞银基金，国信证券，海富通基金，海通证券，海通证券资管，杭银理财，杭州弈宸基金，合众资管，恒安人寿，红杉资本(天津)，红塔红土基金，宏利基金，泓德基金，华安基金，华安证券，华宝基金，华宝信托、华创证券，华福证券，华金证券，华能信托，华泰柏瑞基金，华泰保兴基金，华泰证券，华西基金，华夏基金，华兴证券(香港)，幻方量化投资，汇安基金、汇丰晋信基金，汇丰前海证券，汇丰银行，中航信托，汇添富基金，惠理集团，嘉实基金，建信理财，建银国际证券，交银施罗德基金，景顺长城基金，九泰基金，开源证券，里昂证券，麦格理资本，美银证券，民生加银基金，JKCAPITAL，民生证券，明润投资，摩根大通证券(中国)，摩根士丹利，南方基金，宁波燕园世纪，农银人寿，诺安基金，鹏华基金，平安银行，平安证券，平安资管，浦发银行，浦银国际控股，前海开源基金，群益证券，人保保险，人寿资管，瑞银证券，瑞银资管(香港)，睿远基金，润晖投资，三井住友德思资管，商野村国际证券，上海聚鸣投资，上海瓴仁基金，上海聆泽私募，上海银行，太保资管，太平，太平基金，太平洋保险，太平资管，泰康基金，弢盛资产，天弘基金，文渊资管，西部利得基金，西部证券，西南证券，信达证券，兴合基金，兴华基金，兴业基金，兴业银行，兴业证券，兴银理财，</p>

	<p>兴证全球基金，兴证证券资管、易方达基金，银河基金，银华基金，英大基金，永赢基金，圆信永丰基金，长城财富资管，长江养老，长江证券，长江证券资管，长盛基金，招商证券，浙商证券，中国国际金融，中国人保资管，中国银河证券，中海基金，中欧基金，中泰证券，中投国际(香港)，中信保诚基金，中信保诚资管，中信建投证券、恒越基金，中信证券，中银，中银国际证券，中银基金，中邮证券，中再资管， Awpice Capital, Balyasny Asset Management, Dymon Asia, HelVed Capital, Marco Polo Pure, Neuberger Berman, oberweis AM, Point72HongKong, StillPoint Investment, UG Investment , Advises LTD 等 500 余家投资机构。</p>
<p>公司接待人员</p>	<p>董事长虞仁荣、总经理王崧、董事/全球业务高级副总裁吴晓东、董事/财务总监/副总经理贾渊、董事会秘书任冰、中国区财务总监徐兴</p>
<p>时间</p>	<p>2024 年 4 月 28 日 10:00-11:10</p>
<p>地点</p>	<p>电话会议</p>
<p>交流内容</p>	<p>公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营情况介绍：</p> <p>整体来看，公司 2023 年度公司实现主营业务收入 209.66 亿元，较上年增加 4.65%。其中，因为受到市场需求较弱的影响，分销业务实现收入 29.70 亿元，较上年减少 16.68%，半导体设计业务收入实现 179.40 亿元，较上年增加 9.34%，凭借公司突出的产品优势，半导体设计业务的成长较为明显。</p> <p>在半导体设计业务中，图像传感器解决方案在 2023 年实现营业收入 155.36 亿元，占主营业务收入的比例约为 74%，较上年增加 13.61%，是公司半导体设计业务收入增长的主要贡献来源。特别是公司图像传感器来自智能手机及汽车市场的营业收入规模实现了较大幅度增长。其中，来源于智能手机市场的收入上升至 77.79 亿元，约占公司图像传感器业务的 50%，较 2022 年增长超 44%。来源于汽车市场的收入提升至 45.47 亿元，约占公司图像传感器业务的 30%，较上年增长超过 25%。</p> <p>触控与显示解决方案在 2023 年度实现营业收入 12.50 亿元，出货量达到 1.33 亿颗，出货量较 2022 年增长超过 65%，市场份额得到了较大幅度提升。</p> <p>模拟解决方案在 2023 年度实现营业收入 11.54 亿元。值得一提的是，公司在车用模拟方面有了突破，车用模拟 IC 占公司模拟业务收入的比例达到了</p>

13%，这也为公司模拟业务成长注入了新的活力。

在资产及负债方面，2023 年度公司持续的推进库存去化，公司的库存金额从上年末的约 124 亿降低至年末的约 63 亿。公司主要库存采用先进先出的会计政策，伴随着历史成本库存去化的顺利推进，公司产品毛利率得到了稳步提升。公司相信伴随着收入结构的持续优化，毛利率水平还将继续提升。库存的消化也为公司带来了持续的大额经营活动现金净流入，公司资产负债率持续改善，有息负债规模显著下降，这也使得公司能有更健康的资产状态应为未来的发展机遇，同时公司的财务费用实现了显著下降。

公司持续稳定的加大在各产品领域的研发投入。2019 至 2023 年度，公司研发投入累计已达 125 亿元，这为公司核心竞争力的提升打下了坚实的基础。公司将积极推进研发成果的产业转化，为公司业绩增长提供助力。

聚焦 2024 年第一季度业绩，公司主营业务维持了良好的发展态势，实现营业收入 56.44 亿元，较上年同期增长超过 30%。2024 年第一季度因股权激励确认的股份支付费用约为 0.69 亿元（2023 年第一季度股份支付费用约为-0.75 亿元），剔除股份支付费用影响后，2024 年第一季度归属于上市公司股东的净利润约为 6.16 亿元（已考虑股份支付相关税费），较去年同期增长约 357.20%。

问答环节主要内容：

问题一：公司智能手机领域有什么新产品的规划？

答：公司有专门的团队在对于像素技术、低功耗、HDR、低噪声等方向做深入持续的研究，有着大量的自有底层专利技术，我们认为依靠技术研发的领先性，成功是可以持续的。公司此前在手机旗舰机型主摄应用上份额有限，而此次在智能手机高端市场成功突破，在大量高端机型主摄上取得份额，都归因于公司对研发不断投入，公司在低功耗、DCG 等技术上的表现走在了行业领先的位置。

问题二：汽车 CIS 有怎样的增长目标和规划？

答：今年汽车 CIS 会保持较好的增长，主要因为公司在技术层面的领先，促使产品型号不断丰富，产品序列能够充分满足客户的需求。伴随着自动驾驶

的快速渗透，公司汽车 CIS 的出货量也相应得到较大提升。

汽车市场除图像传感器外，公司也大规模投入了其他产品，包括 MCU、SBC、PMIC、SerDes、TDDI 等，今年很多产品处在推出产品、design-win 过程中，营收端在未来会逐步体现。

汽车业务能持续不断增长有着以下方面的重要支撑：第一，公司强大的自有底层 IP 库能保障高性能产品的持续产出，第二，严格的质控管理体系；第三，强大的供应链体系。公司在汽车业务上有大规模的投入，希望能给汽车客户提供更为全面的解决方案。

问题三：汽车 CIS 的新产品 OX08D10 有哪些优势竞争优势？

答：公司推出的 OX08D10 图像传感器，是首款采用 TheiaCel™技术的 800 万像素产品，OX08D10 具有业界领先的低光性能和低功耗，尺寸比其他同类车外传感器小 50%。这是首款采用豪威集团全新 2.1 微米 TheiaCel™技术的图像传感器，该技术利用下一代横向溢出积分电容器（LOFIC）和豪威集团的 DCG™高动态范围（HDR）技术，在各种照明条件下都能消除 LED 闪烁。凭借 TheiaCel™，OX08D10 能够在高达 200 米之外实现 HDR 图像捕捉。这一范围可在 SNR1 和动态范围之间实现最佳平衡，可为用于高级驾驶辅助系统和自动驾驶的车外摄像头提供更高的分辨率和图像质量。OX08D10 已兼容用于自动驾驶开发的 NVIDIA Omniverse™平台，已与高通 Snapdragon Ride™平台、Snapdragon Ride™ Flex 系统芯片（SoC）和 Snapdragon®Cockpit 平台预集成。这有助于公司在自动驾驶相关领域的份额提升。

问题四：公司在工业 CIS 市场是怎样的战略布局？

答：公司是从前年开始大规模投入工业 CIS 市场，现在产品已在国内外大小客户导入或在导入过程中。目前该业务营收基数还比较低，公司希望能成为全球工业 CIS 市场的主要玩家。公司对该业务会取得较为高速增长的信心主要来源于公司在 global shutter 技术上的不断投入和其领先的技术优势，公司第一代工业 CIS 产品目前已获得了大客户的性能认证。

问题五：公司现阶段在 TDDI 市场的关注点是什么？以及 OLED DDIC 的产品进展？

答：在 TDDI、OLED DDIC 领域，公司持续在做 IP 的设计和迭代。一方

	<p>面，通过设计和工艺优化，推动 TDDI 产品成本端优化；另一方面，积极推进 OLED DDIC 产品的研发和在客户端的验证。</p> <p>问题六：汽车电子市场的毛利率是否存在压力？</p> <p>答：公司有着强大的内部工艺团队，通过和供应链端的合作开发，能生产出更具成本优势的产品，避免产品同质化。从目前来看，公司汽车产品的毛利率维持稳定。</p> <p>问题七：公司对半导体周期有什么看法？</p> <p>半导体行业有周期性，但是企业发展与公司自身产品技术实力关系更大。公司技术是否领先、IP 是否足够优质、产品线是否足够丰富，对公司的发展成长更加重要。</p> <p>公司目前无论在手机、还是汽车市场的份额增长，是基于技术上的领先；公司会努力做到明年、后年及更长时间维度上持续的技术领先，这样公司发展受行业周期的影响就会较为有限。</p>
--	---